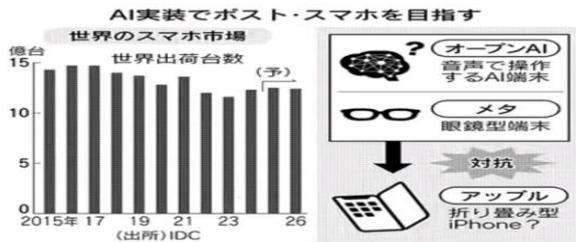


■ **CES (CocsumerElectronicsShow)** (2026.1.6~1.9 ラスベガス)

□ **ポスト・スマホ探る** トレンドはAI 端末か 2026.1.6

2026年のテクノロジー業界は、生成AI（人工知能）を端末や社会にどう実装するかが注目される。米国時間6日には世界最大のテクノロジー見本市「CES」が米ラスベガスで開幕し、26年のテックトレンドを先取りする。生成AI開発は過熱投資への懸念もあり、価値の創出が問われる1年になる。



□ **CES、主役はAIロボ** 半導体握るエヌビディアが旗振り 2026.1.8

姿消す日本家電 ソニー本体出展せず/パナはAIにシフト  
AI（人工知能）の進化を映し出すように、AIを使った新技術の展示が目立つ。かつてはCESで家電製品を披露してきた日本企業にも変化が訪れている。



□ **AIロボは人手補う「移民」か** 米CESのテーマに 2026.1.8

エヌビディアCEOが肯定論 技術者らは代替警戒  
CESでは人工知能（AI）の雇用への影響が大きなテーマとなった。米エヌビディアのジェンソン・ファン最高経営責任者（CEO）はAIを搭載したロボットを、労働力を補う「移民」として受け入れていく必要があると提唱。肯定的な見方と警戒論が交錯した。

□ **CESに戻った中国企業** 米テクノロジー見本市閉幕 2026.1.10

本社移し関税回避も 「トランプ後」にらむ  
CESが9日に閉幕した。今年はソニーグループなどの日本企業が出展を見送るなか、近年鳴りを潜めていた中国企業の存在感が復活した。米政府による米中のデカップリング（切り離し）をすり抜けようと、したたかに米国で営業する中国勢の姿があった。

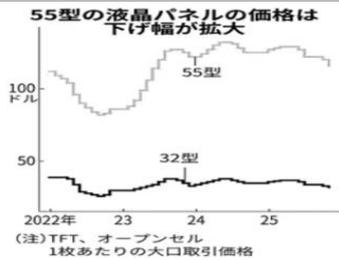


## ■ディスプレイデバイス（液晶・有機 EL）

### □TV液晶パネル下落 11月、2年5カ月ぶり安値

2026. 1. 6

テレビに使う液晶パネルの価格が2カ月連続で下落した。大型品の指標となる TFT55 型オープンセルの 2025 年 11 月の価格は前月に比べて 4 ドル（3%）安い 1 枚 116 ドル前後と、2年5カ月ぶりの安値となった。下落率は 10 月の 2%から拡大した。



### □AGC、ヘッドアップディスプレイ開発 反射率5倍超

2026. 1. 6

#### サングラス着用でも鮮明

AGCは乱反射光を遮る偏光サングラスを着用していても鮮明に表示が見える車載用のヘッドアップディスプレイ（HUD）を開発した。フロントガラスとは独立したパネルを設置する方式で、独自のコーティング技術により反射率を従来のフロントガラスに直接照射する方式に比べ、5倍以上に高めた。すでに欧州の完成車メーカー（OEM）での採用が決まっており、2028年ごろに搭載車が発売される見通し。

### □Samsung が、煩わしい折り目をなくす新しい技術を発表

2026. 1. 7

CES 2026 で、サムスンディスプレイは中央の折り目が完全になくなった新しい折りたたみ式スクリーン技術を正式に発表した。どんなに極端な角度から見ても、完全に平坦な表面を実現している。

この進歩の秘密は、全く新しい機械構造。従来の支持構造の代わりに、ディスプレイパネルの下にレーザーカットされた超薄型の金属プレートを組み込んだ。この技術により、ヒンジ部全体に機械的な圧力が均等に分散され、一軸に集中することがなくなる。開いた際に応力が完全に分散され現在の折りたたみ式スマホに特徴的な折り目の発生を防ぐ。

### □韓国 LG、薄さ 9mm 「Wallpaper TV」発表「目指したデザインが完成」

2026. 1. 5



韓国 LG Electronics は、薄さ 9mm という“壁紙”デザインの有機 EL テレビ「LG OLED evo W6(Wallpaper TV)」を発表した。2017 年に発表した「Wallpaper Design」を復活させたモデル。主要部品の徹底的な小型化と内部アーキテクチャの再設計により、9mm という薄さを実現しつつ、構造的な堅牢性も確保したという。有機 EL パネルでは、反射を抑えつつ黒や色、明るさを強化するという「Hyper Radiant Color Technology」を採用。輝度を高める「Brightness Booster Ultra」も搭載しており、LG OLED evo W6 では従来の有機 EL と比べて、最大 3.9 倍の明るさを実現している。

□サムスン、「AI 体験をより身近かつ信頼あるものに」  
130 型マイクロ RGB LED 液晶テレビ実機展示も

2026. 1. 6



サムスンが発表した 130 型のマイクロ RGB LED 液晶テレビ

「CES 2026」本開催の前々日となる 4 日にサムスン電子のプレス向け記者会見が開かれ、独自の AI アシスタント「Vision AI Companion」を搭載するスマートテレビや、Bixby 対応の生活家電の新製品などが発表された。130 型のマイクロ RGB LED 液晶テレビも公開。バックライトユニットに大きさ 100 $\mu$ m 未満の赤・緑・青 (RGB) マイクロ LED を用い、それぞれが独立発光する仕組みを採用、液晶テレビの一種。高精度な光制御と優れた色再現性を特徴とする。

□TCL CSOT、98 型 RGB LED や印刷式 RGB OLED 披露。世界初のスライド式車載パネルも  
2026. 1. 8



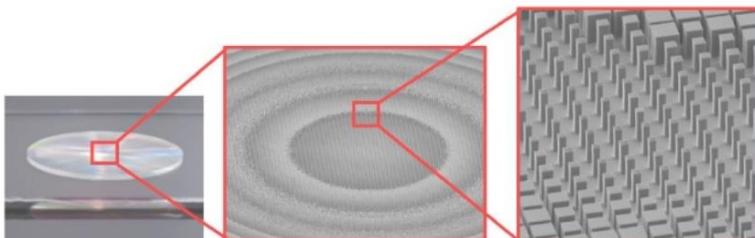
世界初のスライド式&マルチカーブデザインの車載用 OLED (28 型)

TCL CSOT は、「CES 2026」にて、98 型 RGB LED や RGB ストライプ構造の印刷式 OLED など最新のディスプレイ技術を発表した。98 型の HVA Ultra Infinity View TV ディスプレイは、高度な RGB バックライト技術を搭載した新しい液晶パネル。18,000 のローカルディミングゾーンと、BT. 2020 の幅広い色域をサポート。映り込みの少ないアンチグレア加工の表面と、非常に薄いベゼル設計により、「没入感を高め、真の映画体験を実現する」としている。世界初という、スライド式&マルチカーブデザインの車載用 OLED ディスプレイも発表。RGB のピクセルレイアウトと、16 型から 28 型まで伸びるスライド機構を備えているのが特徴。製造はインクジェットプリント式。

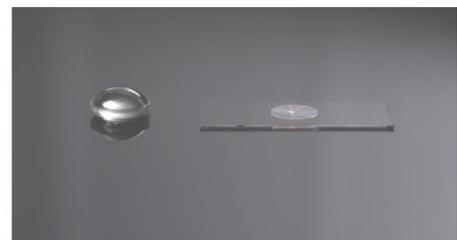
□京セラ、メタレンズで空中映像 厚さが 1mm 以下に

2026. 1. 19

京セラは、メタレンズ技術を活用し、光学系の小型化と奥行き感のある映像表現を両立したスマートウォッチ型の「ウェアラブル空中ディスプレイ」を開発「CES 2026」で初公開した。赤色と緑色の映像表示が 2~3cm 浮いて見える。視野角は $\pm 10$ 度である。従来の凹凸レンズ (左) と京セラが開発したメタレンズ (右) の比較。メタレンズは平面状で厚さは 1mm。

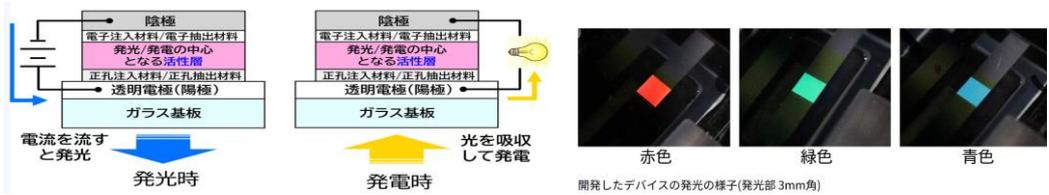


メタアトムイメージ。光の波長より小さなナノメートル (nm) オーダーの柱状構造をしている (出所: 京セラ)



従来の凹凸レンズ (左) と京セラが開発したメタレンズ (右) の比較。メタレンズは平面状で厚さは 1mm (出所: 京セラ)

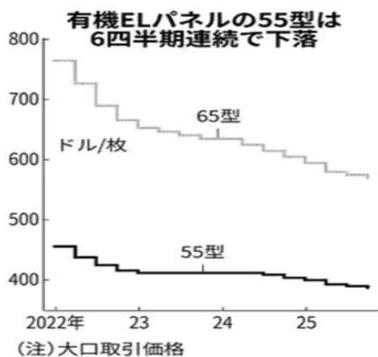
**□NHK技研 発電できる有機 EL～発光・発電を両立したデバイスでの青色発光は世界初** 2026. 1. 21



NHK 放送技術研究所は、千葉大学先進科学センターの深川弘彦特任教授、京都大学大学院理学研究科の畠山琢次教授と共同で、一つの素子で「発光」と「太陽光発電」を切り替えて使用できる「発電できる有機 EL ディスプレーデバイス」の開発に成功した。発光と発電を両立したデバイスで青色の発光を実現したのは世界で初めて。

**□有機 EL パネル最安値 10～12 月大口 配信普及でテレビ不振** 2026. 1. 28

有機 EL テレビに使うパネルの取引で最安値の更新が続いている。指標品の大口取引価格は 2025 年 10～12 月期に 6 四半期連続の下落で決着した。動画配信サービス普及の影響や高価格が敬遠されたことで、有機 EL テレビの需要が振るわない。



**■半導体**

**□次世代半導体向けサポートウエハーの生産能力を 3 倍に** 2025. 12. 11

日本ガイシは、次世代半導体市場への対応を強化するため、ハイセラムキャリアの生産能力を約 3 倍に増強する。ハイセラムキャリアは、複数の小型半導体チップを組み合わせることで高性能を実現するチップレット集積において、半導体チップを一時的に固定するための支持材。この支持材に光を通す他、高い剛性と耐久性を備えた透光性セラミックス「ハイセラム」を採用している。ハイセラムを用いることで、従来のガラス製サポートウエハーで課題となっていた、製造時の反りや破損を大幅に低減す、製造工程の安定性が向上し、製品ロスの削減や品質向上につながる。

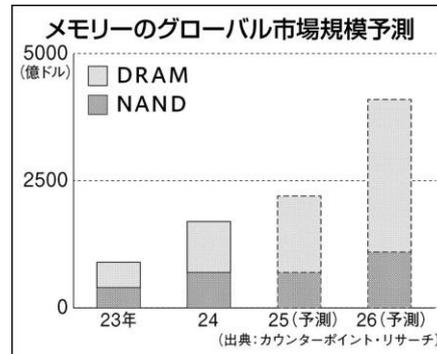
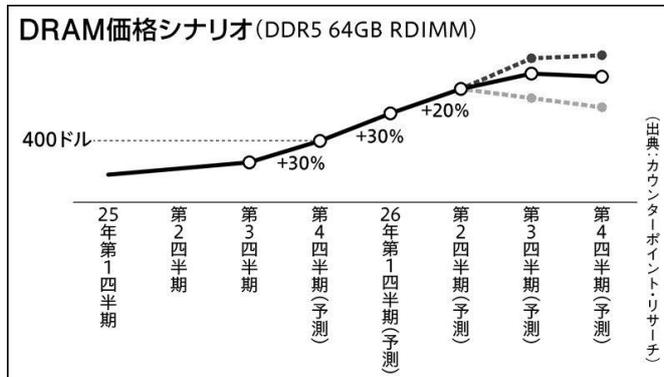
**□サムスン注目の半導体新興 放熱材・封止材開発の「応用技術研究院」** 2026. 1. 7

中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）出身の技術者が日本で設立した、半導体素材スタートアップが韓国サムスン電子系の商社などから約 13 億円を集めた。日本の素材技術に対する世界からの注目を象徴するが、技術流出をどう防ぐのか課題も浮かぶ。そのスタートアップは中国出身の郭若峰・最高経営責任者（CEO）が 2022 年に設立した「応用技術研究院」だ。横浜市の工業地帯の一角に研究開発拠点を構える。

**□メモリー価格 “天井見えず” AI 向けにシフト、不足深刻化  
スマホ・パソコン部品コスト直撃、販売価格にも影響**

2026. 1. 1

半導体メモリーの価格上昇が止まらない。特にDRAM大手がAI向けに必須な広帯域メモリー（HBM）への生産シフトを加速したことで、産業向けの利用も多いLPDDR4の不足感が増した。NANDでも同様の傾向になりそうだ。各社が生産能力増強に慎重な構えを崩していない現状では、価格の高止まりは継続する公算だ。



一方、中国のメモリーメーカーでは景色が異なる。中国の大手メモリーメーカーはDRAMを手がける長鑫存儲技術（CXMT）とNANDの長江存儲科技（YMTC）がある。既に両社はスマホや産業機器向けに適用できる製品を製造しているとみられ、中国国内でのシェアは高い。現地では「韓国製よりも2—3割安い」（業界筋）という価格競争力を強みに、韓国メーカーからシェアを奪っているもようだ。

**□26年半導体市場はメモリー争奪 サムスンは最高益、スマホ供給懸念も** 2026. 1. 9

2026年の半導体市場はメモリーの奪い合いが波乱要因となる。生成AI向けの需要で汎用品も逼迫する。手がける企業の業績を上押しする半面、メモリーの不足や価格高騰でスマホやパソコンの生産が滞れば、こうした機器に搭載されるCPUや汎用半導体の需要回復にブレーキがかかりかねない。

AI関連やメモリーの供給不足 ← バランス → 供給過剰

供給動向について1点(供給過剰)～5点(供給不足)で評価を依頼し平均値から作成

用途	25年		26年			
	10~12月	1~3月	4~6	7~9	10~12	
パソコン	➡	➡	➡	➡	➡	
スマートフォン	➡	➡	➡	➡	➡	
自動車	➡	➡	➡	➡	➡	
生成AI向けデータセンター	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	
GPUなど	➡	➡	➡	➡	➡	
AI用メモリー	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	
汎用メモリー	⬆	⬆	⬆	➡	➡	
パワー	➡	➡	➡	➡	➡	
アナログ	➡	➡	➡	➡	➡	

**□LGイノテックがUTIとガラス基板強化技術を共同開発しFC-BGA競争力強化**

2026. 1. 8

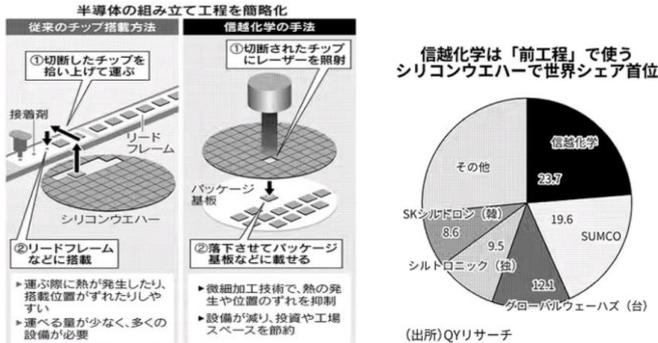
LGイノテックは半導体パッケージング市場の構図を変える次世代技術であるガラス基板事業の競争力強化に向け、ガラス精密加工の専門企業であるUTIと研究開発で協力すると8日に明らかにした。双方は次世代半導体基板であるガラス基板の強度を高める技術を共同開発する計画。LGイノテックは韓国の事業所にガラス基板の試験生産ラインを構築し、グローバル顧客企業や国内外のガラス基板技術保有企業と協業して技術開発を加速している。とりわけ最近注力している高付加価値半導体基板のFC-BGAにガラス基板技術を適用し、事業競争力を強化する方針だ。

**□信越化学、半導体を微細加工**

2026. 1. 9

**低コストの装置と材料、27年提供 AIにらみ「後工程」開拓**

信越化学工業は半導体の微細加工で新たな顧客を開拓する。半導体チップを完成品に組み立てる「後工程」で、コスト低減や生産効率化が可能な装置や材料を2027年から提供する。人工知能需要の拡大をにらんで後工程の事業にも注力し、事業の裾野を広げる。



**□光電融合技術 高速・省エネで情報処理 「IOWN」研究着々**

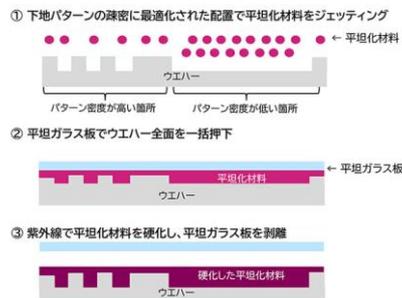
2026. 1. 13

**データ伝送、光通信に置き換え 中核技術にシリコンフォトニクス**

次世代技術の注目分野として光電融合技術が脚光を浴びつつある。光電融合技術とは光と電気の融合により、情報処理の高速化と省電力化を同時に実現する画期的な技術。生成AIの普及などによるデータ流通量の増加は、データセンターなどのインフラを中心とする電力使用量の増大が懸案事項となっており消費電力抑制の切り札として期待が高まる。

**□キヤノン、ウエハー平坦度向上 ナノインプリント応用**

2026. 1. 14



IAP 技術による平坦化工程 (キヤノン提供)

キヤノンは、露光装置に代わる次世代半導体製造装置「ナノインプリントリソグラフィ (NIL) 装置」の技術を使い、ウエハーの平坦度を高める新装置を2027年に製品化すると発表した。ウエハー表面の凹凸を5ナノメートル以下に抑える。先端ロジックやメモリーで適用が増えている化学機械研磨 (CMP) などの一部工程を置き換える。

**□半導体レジスト、30年ぶりの新星 MOR サムスンなど採用へ**

2025. 12. 5

フォトリソに約30年ぶりの新顔が加わりそうだ。金属酸化物レジスト (MOR) と呼ぶ新型レジストの供給が2026年に始まる見通しで、韓国 Samsung Electronics などが2026~27年に半導体の量産に導入する公算が高まった。次世代のEUV (極端紫外線) 露光と組み合わせられて使われる。ADEKAはレジストメーカー向けにMOR用材料の供給を始めた。金属と有機分子を結合させた金属錯体と呼ぶもので、MORの中核材料となる。MORは金属を使う新しいタイプのレジストで、約30年にわたり業界標準だった有機高分子系の化学増幅型レジスト (CAR) よりも露光の解像度を高められる。MORには液状レジストを半導体ウエハーに塗布するウェットと、化学的気相成長法 (CVD) でレジストを成膜するドライの2方式がある。半導体製造装置メーカーにとってゲームチェンジャーとなる。

**□世界の半導体市場、昨年 21%増 125 兆円 ガートナー調べ  
首位エヌビディア、売上高 1000 億ドル突破**

2026. 1. 14

米調査会社ガートナーによると、2025 年の世界の半導体市場は前年比 21%増の 7930 億ドル（約 125 兆円）だった。24 年に続き、A I プロセッサーや広帯域メモリー（HBM）など A I 半導体が伸びた。個別企業のランキングでは、画像処理半導体（GPU）最大手の米エヌビディアが売上高で同 63.9%増の 1257 億ドル、シェア 15.8%と首位。売上高が 1000 億ドルを超えた初めての半導体メーカーになった。

	社名	前年比増減率(%)
1	米エヌビディア	63.9
2	韓国サムスン電子	10.4
3	韓国SKハイニックス	37.2
4	米インテル	▼3.9
5	米マイクロンテクノロジー	50.2
6	米クアルコム	12.3
7	米ブロードコム	23.3
8	米AMD	34.6
9	米アップル	19.9
10	台湾メディアテック	15.9

ガートナーの資料を基に作成。▼はマイナス

**□中国 AI 半導体、脱エヌビディア**

2026. 1. 17

**政府も「自立自強」へ支援 年内に国内自給率 8 割も**

中国の人工知能（AI）半導体企業が急成長している。新興の摩爾線程智能科技（ムーア・スレッド）などが製品開発を急ぎ、政府も「自立自強」へ支援を強める。2024 年に 3 割だった国内自給率は 26 年に 8 割へ高まるとの予測もある。

順位	社名	シェア(%)
1	ハイシリコン (ファーウェイ)	50
2	米AMD	12
3	カンブリコン	9
4	海光/曙光	8
5	米エヌビディア	8
6	平頭哥 (アリババ)	5
7	崑崙芯 (百度)	3
8	MetaX	2
9	紫霄 (テンセント)	1
10	ムーア・スレッド	0.4

(出所) 中国メディアが報じた米調査会社バースタインの報告をもとに作成。一部はブランドを含む

新興4社「GPU四小竜」	ムーア、MetaX、ピレン、エンフレーム
テック大手	崑崙芯(百度)、平頭哥(アリババ)、紫霄(テンセント)、ハイシリコン(ファーウェイ)
中国政府系	カンブリコン、海光、曙光

(注) 一部はブランドを含む  
(出所) 中国メディアの報道などから作成

**□台湾が米国と関税合意、半導体など 40 兆円投資 相互関税は 15%に下げ**

2026. 1. 17

米商務省は 15 日、米国と台湾の貿易交渉が合意に達したと発表した。台湾企業が半導体を中心に 2500 億ドル（40 兆円）の対米投資を約束し、米国は台湾にかける 20%の相互関税を、既存税率と合計で 15%まで下げる。

**□ヌヴォトン、紫外半導体レーザー出力向上 マスクレス露光用**

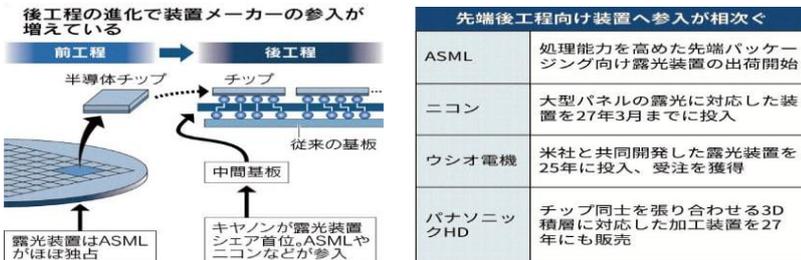
2026. 1. 19

ヌヴォトンテクノロジージャパン（京都府長岡京市）は、先端半導体パッケージ向けマスクレス露光用に、出力を高めた紫外半導体レーザー「KLC330FLO1WW=写真」を開発した。出力 1・0ワットで、同社によると一般的なパッケージの同波長レーザーでは業界最高クラス。半導体の回路線幅の微細化が技術やコストの面から限界を迎える中、適用が進む 3次元（3D）パッケージやチップレット向けに提案する。

**□ 蘭 ASML、半導体の後工程に参入 ニコンも挑戦**

2026. 1. 21

**組み立て装置、キヤノンの牙城 AI 向けで需要**半導体の製造プロセスで最終製品に組み立てる「後工程」に、露光装置で世界最大手の ASML ホールディングが参入した。チップ同士をつなぐ層に配線を描くための装置で、同分野をほぼ独占するキヤノンに挑戦する。ニコンも 2026 年度の量産を目指している。最先端半導体の性能を高めるために後工程も重要になっている。



**□ TOPPAN、半導体 3 部材に 400 億円 石川に新ライン、製造法確立へ**

2026. 1. 27

TOPPANは、ガラスコアの半導体パッケージ基板「FC-BGA」、ガラスインターポーザー（中間基板）、有機再配線層（RDL）インターポーザーの三つの部材の製造技術の確立に向けて400億円を投じる。石川工場にパイロットラインを導入し、機能の異なる複数の半導体チップを一つの基板に集積する「チップレット」に対応した次世代半導体パッケージに必要な部材の研究開発を加速する。同ラインは2026年7月の稼働開始を目指す。大阪公立大学などと連携し、510mm\*515mm パネル型の有機材料に対して、絶縁膜に配線溝を掘った後に銅を埋め込み、最後に余分な銅を研磨除去する「ダイヤモンド工法」を用いた製造技術を開発する。

**□ ガラス基板信頼性底上の一手、Taesung、TGV 後工程で存在感**

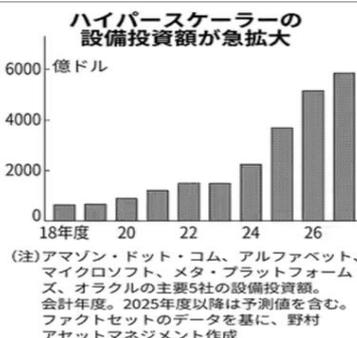
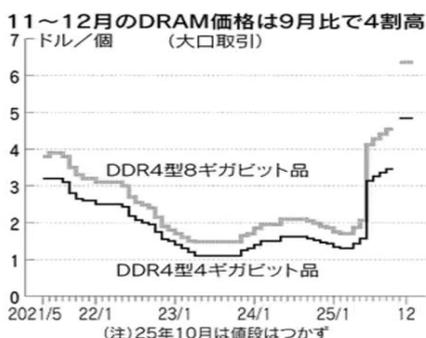
2026. 1. 27

韓国の PCB 装置メーカー Taesung は、ガラス基板メーカー JWMT（旧 Zhongwoo M-Tech）から先端 TGV（Through Glass Via）向けガラス後工程装置を受注したと発表した。新装置は、レーザー分離後のガラス切断と、マイクロクラックを低減しエッジ強度を高める化学ヒーリング工程を統合。従来のブレイク方式に比べ、信頼性を大幅に向上させる。装置は次世代パッケージ向け TGV ガラス基板の量産ラインに導入される。

**□ DRAM、大口価格 4 割高 11~12 月 AI 向け優先で品不足 パソコン出荷に影響**

2026. 1. 29

半導体メモリーの DRAM が一段と値上がりした。指標品の 2025 年 11~12 月の大口取引価格は、前回価格交渉が成立した 9 月に比べ 4 割高で決着した。世界大手がデータセンターに置く人工知能（AI）サーバー向けの供給を優先しており、パソコン（PC）など民生分野に使う指標品の供給が不足。需要家は希望数量を確保できていない。

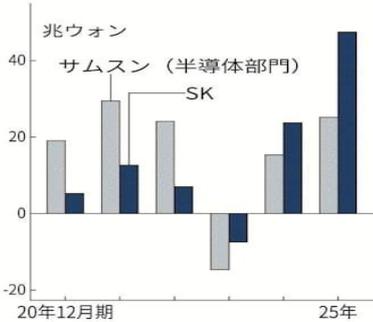


□サムスン・SK、メモリー増産 売上高最高、再投資へ巨費 AI 需要急増、対応急ぐ

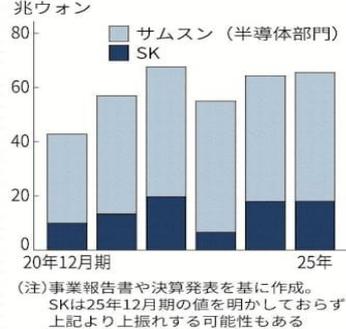
2026. 1. 30

韓国のサムスン電子と SK ハイニックスは好調な業績を発表し、メモリー半導体の設備投資を大きく増やす計画を発表した。人工知能（AI）の普及で需要が急増し、供給が追いついていないため巨額の投資を続ける。中国勢も汎用品を中心に生産を増やしつつあり、需給の見極めが問われる。

韓国半導体2社の営業損益



韓国半導体2社の設備投資の推移



□中国 半導体装置を国産化 昨年、世界上位20社に3社 米の輸出規制で台頭

2026. 1. 31

世界の半導体製造装置の上位20位

2022年			25年 (見込み)	
企業名	売上高 (億円)	順位	企業名	売上高 (億円)
アプライドマテリアルズ (米)	23224	1	ASML	39797
ASML (オランダ)	20589	2	アプライドマテリアルズ	30292
東京エレクトロン	16056	3	ラムリサーチ	18697
ラムリサーチ (米)	11770	4	東京エレクトロン	17132
SCREENセミコンダクターソリューションズ	3768	5	NAURA	5027
ASMインターナショナル (オランダ)	2807	6	ASMインターナショナル	4722
荏原	2130	7	SCREEN	4684
NAURA (中)	1329	8	荏原	2899
エキサイト (独)	1697	9	アトラスコポ	2456
アトラスコポ (スウェーデン)	1569	10	村田機械	2135
KOKUSAI ELECTRIC	1480	11	ダイフク	1886
SEMES (韓)	1401	12	キヤノン	1825
日立ハイテック	1371	13	AMEC (中)	1697
ダイフク	1362	14	エキサイト	1614
キューリック&ソフア (シンガポール)	1315	15	ASMPT (シンガポール)	1418
キヤノン	1286	16	テイスコ	1416
アクセリス・テクノロジーズ (米)	1170	17	日立ハイテック	1375
テイスコ	1114	18	IMSナノファブリケーション (オーストラリア)	1368
WONIK IPS (韓)	1086	19	KOKUSAI ELECTRIC	1208
BEセミコンダクター・オンダストリーズ (オランダ)	952	20	SMEE (中)	1165

(注) グローバルネットが各社の半導体製造装置の売り上げを基に集計。試験・稼働装置は対象外。濃い緑は中国企業、薄い緑は日本企業



2025年に世界の半導体製造装置メーカー上位20社に中国企業が3社入り、22年の3倍に増えた。中国は弱みだった装置の国産化率を2~3割に伸ばしたとの見方もある。先端半導体を開発・生産できないよう米国に装置輸出を規制されたが、独自のサプライチェーンを築き始めた。中国政府系の北方華創科技集団（NAURA）が5位に入り、ASMLホールディング（オランダ）、米アプライドマテリアルズ、米ラムリサーチ、東京エレクトロンの世界4強に迫る。01年設立で、回路を削るエッチングや膜を張る成膜など幅広い製造装置を手掛ける。売上高は25年に前年比21%増えた。13位の中微半導体設備（AMEC）はラムリサーチやアプライドで働いた経験を持つ技術者が中国で創業した。台湾や韓国などにも拠点を持ち、主力のエッチング装置は最先端に近い回路線幅5ナノ（ナノは10億分の1）メートル級のチップ製造にすでに採用されているという。20位の上海微電子装備（SMEE）は露光装置を手掛ける。ウエハーに回路を描く露光装置は半導体の性能向上に欠かせない。世界最大手のASMLと比べると旧世代装置が中心だが、数少ない中国露光装置メーカーとして需要を取り込んでいる。

■新技術、材料、電池

□宇宙「生活」向け素材開発磨く 用途拡大、「夢の市場」先手 2025. 12. 29

レゾナック、中性子防ぐ半導体保護材 三井化学、生殖細胞培養キット

次世代の宇宙開発を見据え、素材各社が材料開発に乗り出している。レゾナック・ホールディングスが開発した中性子を防ぐ素材を使った半導体利用の宇宙実験が 2026 年 1 月にも始まる。三井化学は生殖細胞培養キットを開発。宇宙ビジネスは衛星などに加え旅行や居住といった「生活」利用が期待される。技術力を磨き「夢の市場」に先手を打つ。

**宇宙向け新ビジネスの期待高まる**

国が主導  
米の有人宇宙飛行「アポロ計画」など。選抜された宇宙飛行士がISSで実験

新興が台頭  
米スペースXが有人宇宙船を打ち上げ。日本でもispaceなどスタートアップが登場

ISSの後継機が民間移行へ

商業利用が拡大

宇宙飛行 データセンター 定住 創業 高速輸送

**有人探査が再び脚光**

アルテミス計画  
米主導で日欧などが参加し月面で持続的な探査を目指す。火星への有人探査も視野

イーロン・マスク氏が火星移住の構想打ち出す

月探査(アルテミス計画) = NASA提供

**宇宙開発は新たな市場も成長**

2023年 (出所)世界経済フォーラム

**レゾナック、電子機器の誤作動防ぐ**

ホウ素などを配合し、宇宙で電子機器の誤作動を引き起こす中性子を抑制する

日本の実験棟「きぼう」で検証

宇宙のデータセンター設置などに活用

宇宙事業で新興や他業種との共創の場が広がり、研究員のモチベーションも向上する

**三井化学は生殖細胞の培養キット**

酸素透過性が高い独自樹脂フィルム採用。微小重力下の実験向け専用キャップも

28年ごとに宇宙でマウスの精子細胞を培養

宇宙滞在による人間の生殖活動への影響を検証

先端向け技術は後々民生に活用可能  
ものづくりの高度な要素技術をいち早く入手

□世界初の「プラズマ冷却」技術搭載ノートPCが CES 2026 でデビュー 2026. 1. 4

「ファンレス冷却革命」の幕開けか

スペインと米国ニュージャージー州に拠点を置くディープテック企業「YPlasma」は、機械的な可動部品を一切持たない「ソリッドステート（半導体/固体）冷却」を用いたラップトップ PC のプロトタイプを世界初公開すると発表した。従来の「ファン（送風機）」という概念を根底から覆すこの技術は、「誘電体バリア放電（DBD : Dielectric Barrier Discharge）」という物理現象を応用し、プラズマの力で風を生み出す。YPlasmaのアプローチが画期的であるのは従来のコロナ放電ではなく、誘電体バリア放電（DBD）を採用している点にある。

テクノロジー	厚さ	熱伝達率 (W/M <sup>2</sup> ・K)	電力	ノイズ
従来のファン	5~25mm	30~150	1~5W	30~50 dBA
コロナ放電	1~9mm	40~180	0.1~3W	30~40 dBA
ピエゾフロー	2~7mm	30~150	0.5~3W	20~35 dBA
Y-Flow (DBD)	0.5~8mm	50~300	0.1~2W	30 dBA未満

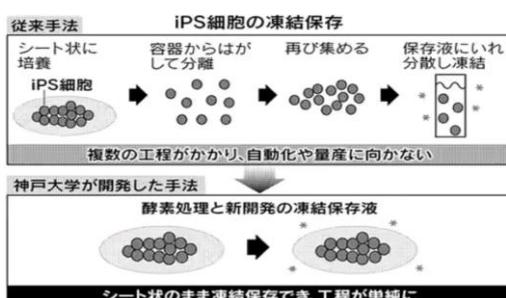
**□TDK、新電池を来年度前半に量産 スマホ向け、薄型・大容量** 2026. 1. 7  
 TDKはスマートフォン向け電池の次世代品の量産を 2026 年度前半に始める。負極にシリコンを使うリチウムイオン電池の最新世代で、より多くの電気をためられる。折り畳みスマホなどの登場で、薄くても大容量の電池が求められていることに応える。

**□日東電工、電気剥離テープ 2 倍超 消費者修理ニーズ拡大** 2026. 1. 13  
 日東電工は電子機器の部品などを固定するための電気剥離テープを増産する。愛知県豊橋市の事業所に 390 億円を投じて新工場棟を建設する計画で、生産能力は 2029 年度に 25 年度比 5 割増える。同テープは電気を流すと固定対象を自由に剥離できるのが特徴。欧米で消費者が製品を修理する権利を保証する動きが拡大する中、電子機器を修理しやすくする同テープは需要が拡大する見通し。新工場棟では折り畳みできるフォルダブルスマホで使われる光学用透明粘着シート（OCA）も生産する方針。

**□ペロブスカイト太陽電池の「弱点」を完全克服** 2026. 1. 13  
 85℃の高温で 1100 時間耐久、「分子の接着剤」が拓くエネルギー革命  
 ペロブスカイト太陽電池は、長らく「夢の材料」と呼ばれながらも、「熱」と「時間」に対してあまりにも脆弱だった。しかし 2026 年 1 月、英国マンチェスター大学の研究チームがブレイクスルーを達成し、科学誌『Science』にその成果を発表した。彼らは「分子接着剤」として機能する新たな化学物質を用いることで、太陽電池の表面欠陥を修復し、驚異的な耐久性を実現したのである。鍵を握るのが、研究チームが開発した「アミジニウムリガンド (amidinium ligands)」と呼ばれる小分子を用いた新しいコーティング技術だ。

**□自己修復”する次世代素材が航空機や宇宙船の「数百年」に渡る使用を可能にする** 2026. 1. 24  
 ノースカロライナ州立大学（NC State）の研究チームが、材料工学の歴史を塗り替える画期的な発明を成し遂げた。彼らが開発したのは、航空機や風力タービンに使用される複合材料の内部損傷を、1,000 回以上も自律的に修復できるという驚異的なテクノロジーだ。従来の複合材料の寿命が数十年であるのに対し、この新素材は 100 年以上、メンテナンス頻度によっては 500 年もの間、構造的健全性を維持できる可能性を秘めている。

**□iPS 細胞の凍結保存に新手法 神戸大学が開発、量産化に道** 2026. 1. 27  
 神戸大学の研究グループは iPS 細胞を凍結保存できる新たな技術の開発に成功した。従来は培養容器からはがして凍結保存する必要があったが、細胞同士の接着を弱め、容器ごと凍結保存できるようになる。今回の工程を自動化できれば、iPS 細胞製品の量産が可能になり、また iPS 細胞を作製してから医療現場に届けるまでの時間を大幅に短縮できる可能性がある。



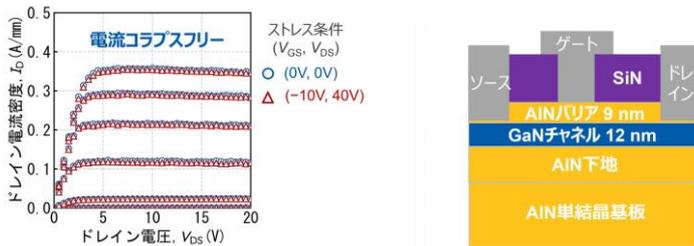
iPS細胞を巡る主な経緯	
2006年	京都大学の山中伸弥教授がマウスでのiPS細胞の作製成功
07年	山中教授がヒトiPS細胞の作製成功
12年	山中教授がノーベル生理学・医学賞を受賞
14年	理化学研究所などのチームが目の網膜の難病患者への移植手術
20年	大阪大学の澤芳樹教授（当時）らがiPS細胞から作った心臓の細胞をシート状にし、心不全患者に移植手術
25年	阪大発新興クオリプスと住友ファーマがiPS細胞由来医薬品の承認申請
26年	世界初のiPS細胞を使った医薬品が日本で誕生？

**□ハドラス、滑雪コート剤 LED信号機・車向け拡販 2026. 1. 27**

ハドラスホールディングス（HD、東京都中央区）は、信号機や交通標識、屋外の手すりなどの積雪対策用に滑雪効果のあるガラスコーティング剤を開発した。強力な撥水効果で雪が固着する前に滑り落ちる仕組み。同社の実験では17度と従来の3分の1程度の傾斜で滑雪効果を確認した。近く販売を始める計画で、雪に弱い発光ダイオード（LED）信号機などへの拡販を進める。自動車の除雪作業の負担軽減用にも供給する方針。

**□旭化成、高周波デバイス性能向上 HEMT 高耐圧・低抵抗化 2026. 1. 23**

旭化成は名古屋大学の須田淳教授・天野浩教授らと共同で、窒化アルミニウム（AlN）基板を使った窒化ガリウム（GaN）の高電子移動度トランジスタ（HEMT）において従来比2倍以上の高耐圧や低抵抗化を実証した。次世代通信規格「6G」をはじめとする通信・レーダーシステム向け高周波デバイスの性能向上につながり、将来の社会実装に貢献するブレークスルーとなりそうだ。



P/AlN 基板上に積層した AlN /GaN/AlN HEMT の模式図

**□ダイセル、マイクロプラント 5月稼働 半導体用ポリマー生産 2026. 1. 30**

ダイセルは小さなガラス板の中に作った微細な流路内で化学素材を生産する「マイクロ流体デバイス」を用い、半導体向けレジストポリマーを試験的に生産する。新井工場（新潟県妙高市）で5月にも始める。2月に同デバイスを使った「マイクロプラント」を設置。試験生産を経てサンプル提供する。大規模プラントで化学素材を製造するのに比べ、必要な量を少ないエネルギーで効率よく作ることができる。生産技術などの開発を重ね、付加価値が高く、高品質が求められる素材生産などに適用を広げる。

**□ペロブスカイト太陽電池の「透明電極」安価に…東洋インキが新工法、30年メド供給へ 2026. 1. 29**

東洋インキは、ペロブスカイト太陽電池の透明電極の回路を形成する「パターニング」について、コストを下げる新工法を開発した。透明電極コストが最大 80%下げられると試算している。今後、フレキシブル基板（FPC）や金属加飾向けなどに提案、実証して工法の信頼性を高め、2030年までにPSC向け透明電極の供給体制を整えたい考えだ。新工法はまず、基板に水溶性インキで導電材料を削らない場所を印刷し、その上に導電材料を積層する。その後、水洗いして水溶性インキとその上の導電材料を除去する。

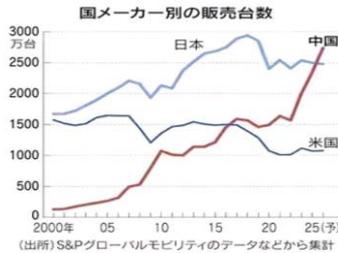


## ■カーエレクトロニクス

### □中国車が世界販売首位に 低価格攻勢、日本抜く 今年 EV 輸出増、強まる摩擦

2025. 12. 30

2025 年新車販売で中国車メーカーの世界販売台数が初の首位になる。米国を抜き 20 年以上首位だった日本車は 2 位になる。中国は自動車輸出が既に首位で自動車大国としての地位を確立する。価格競争力が高い中国勢に対抗するため、各国は関税や新規格で障壁を設ける。世界で摩擦が強まり、自国企業を守る保護主義が強まる恐れがある。

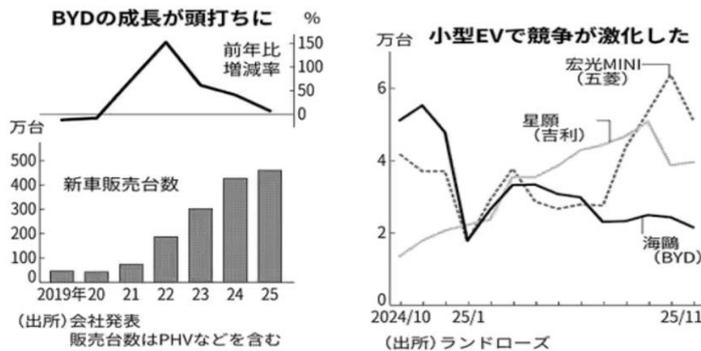


### □BYD、EV世界首位

2026. 1. 3

#### テスラ超え、昨年 225 万台販売 競合が価格と技術で迫る

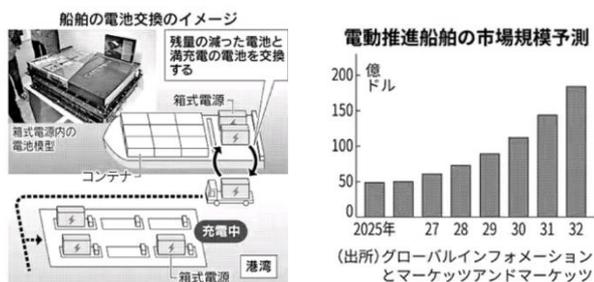
中国自動車大手の比亞迪 (BYD) が暦年ベースで初めて電気自動車 (EV) の世界首位になることが確実となった。2025 年の EV の新車販売は前年比で約 3 割増え、米 EV 大手テスラを引き離したとみられる。新車販売を急速に伸ばしてきた BYD には中国市場での逆風が強まっており、成長の鈍化にも直面している。BYD の 25 年の EV 乗用車の販売台数は前年比 28%増の 225 万台だった。競合のテスラは 164 万台になるそうだと公表している。



### □EV の知見、船舶電池開拓 中国 CATL、900 隻に供給 脱炭素へ外航船向けも

2026. 1. 6

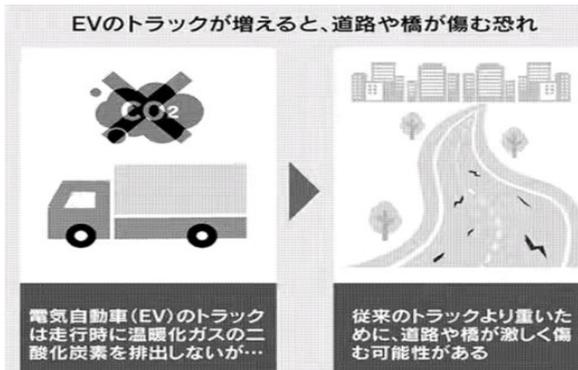
中国の車載電池最大手、寧徳時代新能源科技 (CATL) が船舶の電動化の需要を開拓する。船舶向けの電池や制御システムを開発し、内航船を中心に搭載実績は約 900 隻に達した。今後は遠洋船向けの技術も開発し海運会社などに売り込むことも視野に入れる。水上交通に電池の用途を広げて一段の成長を目指す。



**□重いEV、道路・橋に傷み 再エネ普及に負の側面 太陽光発電、農地を奪う**

2026. 1. 27

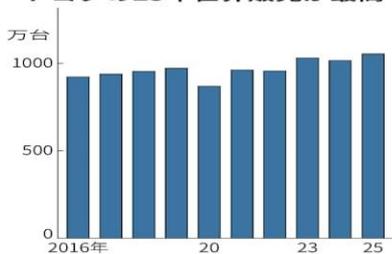
地球温暖化を防ぐために再生可能エネルギーの普及が世界で進むが、思わぬ負の影響が広がる恐れが出ている。重い電気自動車（EV）が増えて道路や橋が傷んだり、発電所の建設で農業や漁業に被害が出たりする可能性を複数の科学研究が指摘する。温暖化ガスの削減をめざすだけでなく、再生エネの利用増加が社会や経済にもたらす様々な「副作用」にも目を配る必要があるようだ。



**□トヨタの25年世界販売、過去最高で6年連続首位 スズキは日産超え** 2026. 1. 29

トヨタ自動車が29日発表した2025年の世界販売台数（レクサス含む）は、前年比4%増の1053万6807台と、過去最高を更新した。ハイブリッド車（HV）が米国などで好調だった。ダイハツ工業、日野自動車含むグループ世界販売も5%増の1132万2575台で最高だった。6年連続で世界首位となった。国内メーカーの世界販売ではスズキが日産自動車を抜き、日本車3位に浮上した。日本車2位はホンダで8%減の352万1905台だった。半導体不足の影響を受けた。世界販売で2位は独フォルクスワーゲングループの898万台。

トヨタの25年世界販売が最高

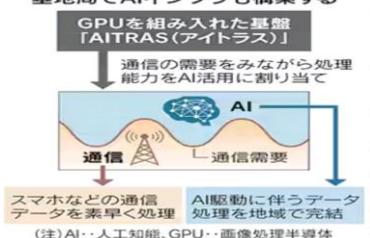


**■通信**

**□ソフトバンクがAI高速通信網を今年整備 自動運転・ロボ普及に道** 2026. 1. 10

基地局でデータ処理ソフトバンクは2026年から、携帯基地局と人工知能（AI）基盤を組み合わせた新しい高速通信網を整備する。通信制御とAIデータ処理を同時にこなす。大規模なデータセンターに頼らず現地（ローカル）でAIを使えるようにする。

基地局でAIインフラも構築する



**□佐賀大発新興、ダイヤモンド半導体を社会実装へ 月内サンプル製販**  
**120ギガヘルツの高周波性能実現**

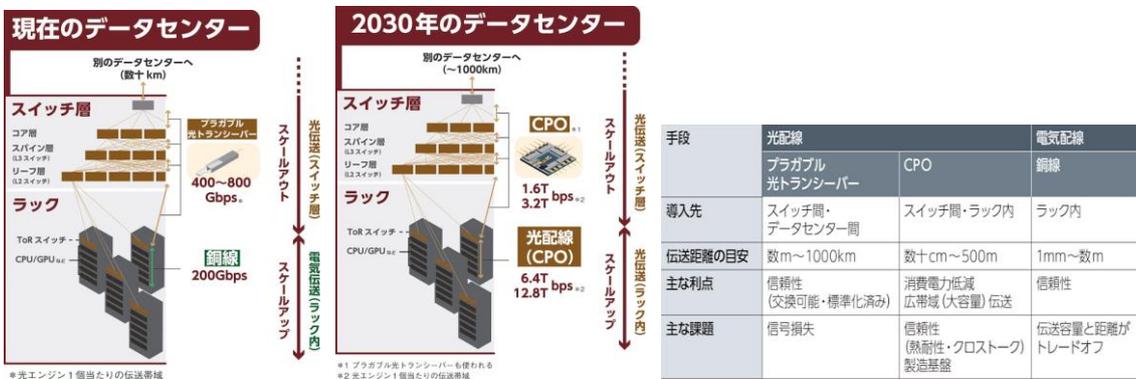
2026. 1. 12

通信用途のダイヤモンド半導体の社会実装に向けた動きが本格化している。佐賀大学発のスタートアップ、ダイヤモンドセミコンダクターは1月からサンプルの製造・販売を順次始める。これに先駆け2025年12月にはマイクロ波帯・ミリ波帯での120ギガヘルツ（ギガは10億）の増幅という高周波性能を確認したと発表。

**□データセンター 光電融合で変貌、GPU間も光化**

2026. 1. 20

AI（人工知能）の普及により、ハイパースケイラー（大手クラウド事業者）が運営するデータセンター内でTbps（テラビット毎秒）級の大容量データをやり取りする必要が出てきた。その実現に向け、電気回路が担っていた一部を光回路に置き換える光電融合の導入が加速していく。今後、サーバーラック内ではGPU（画像処理半導体）のようなAI半導体同士の接続にも光電融合が使われる。



**□NEC、多数アンテナで同時接続 5G 基地局無線機開発**

2026. 1. 26

NECは第5世代通信（5G）に利用する周波数6ギガヘルツ（ギガは10億）より下のサブシックス帯向けに、多数のアンテナから各端末に専用の電波を割り当てることで基地局に同時に接続できる「マッシュMIMO」技術を搭載した新たな基地局装置・無線機（RU）を開発した。現行のアンテナ一体型RUの後継機として、性能評価などの検証を経て、2026年度上期に国内向け、下期には海外向けの提供も目指す。

**■環境/エネルギー/SDGs**

**□北京は大気汚染どう改善？インドが注目 中国も協力へ前向き**

2026. 1. 12

企業が小型測定機配布、大気の状態「AQI (AirQualityIndex)」情報を提供  
 経済発展とともに大気汚染が悪化しているインドで、大気汚染を改善した中国の経験が「北京モデル」として注目され始めている。北京での実体験から、大気の状態や健康への影響がわかるウェブサイトを立ち上げた起業家もいる。



大気の状態を数値化したAQIの結果とともに表示される男の子のキャラクター。「良い」から「危険」まで6段階ある＝ウェブサイトの運営などをするプラナエア提供

■企業動向、製品動向

□A I 株高、来年も続くか 3 銘柄、日経平均上昇幅の 5 4 % 占める 2025. 12. 31  
「ソフトバンクグループ」「アドバンテスト」「東京エレクトロン」

2025 年の日経平均株価は年間 1 万円超の歴史的な上昇幅を記録し、5 万円台でフィニッシュした。トランプ米政権の関税政策や高市早苗政権の誕生で乱高下する相場を、A I ・半導体関連の銘柄が引っ張った。2 6 年も A I 株高が続くかは、米国の金融政策が大きな鍵を握りそうだ。



東証プライムの  
時価総額上位企業 (億円)

1	トヨタ自動車	530,079
2	三菱UFJFG	295,862
3	ソフトバンクグループ	251,321
4	ソニーグループ	247,468
5	日立製作所	224,588
6	三井住友FG	194,451
7	ファーストリテイリング	181,195
8	東京エレクトロン	161,864
9	伊藤忠商事	156,507
10	アドバンテスト	150,431
11	三菱商事	144,477
12	NTT	142,797
13	みずほFG	141,921
14	中外製薬	138,404
15	リクルートHD	138,359

16	キーエンス	137,850
17	任天堂	137,596
18	三井物産	134,913
19	三菱重工業	129,548
20	KDDI	113,427
21	日本たばこ産業	112,800
22	東京海上HD	112,500
23	ソフトバンク	102,944
24	三菱電機	96,890
25	信越化学工業	96,728
26	富士通	89,658
27	HOYA	81,268
28	ホンダ	81,100
29	ゆうちょ銀行	78,991
30	武田薬品工業	76,924

※今年末の終値で計算。政府保有分を含む

□中国軍民両用品の対日輸出規制 レアアース対象か 経済圧力強める 2026. 1. 7/8

中国政府は 6 日、軍民両用の規制に基づいて日本への輸出規制を強化すると発表した。高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁を念頭に、経済圧力を強める。レアアース（希土類）関連製品も対象に含むとの指摘もあり、日本の産業に影響が出る可能性がある。

レアアースは幅広いハイテク製品に不可欠

セリウム	半導体製造用の研磨剤、自動車用排ガス触媒
ランタン	ニッケル水素電池、光学レンズ
ネオジム	電気自動車のモーター用磁石
ジスプロシウム	

イットリウム	発光ダイオード(LED)など向け蛍光体
テルビウム	
プラセオジム	高性能磁石

レアアースは基幹産業で広く使われる

企業名	用途
村田製作所	自動車やスマホ、AIサーバーなどに使うコンデンサー
信越化学工業	
プロテリアル大同特殊鋼	EVなど電動車モーターの磁石
TDK	
三井金属	液晶パネル製造向けの研磨材
ミネベアミツミ	スマホカメラ向けの駆動装置
安川電機	産業用ロボットのモーター

□国産レアアース開発へ始動 南鳥島沖に探査船出航、経済安保に備え 2026. 1. 13

電気自動車（EV）や医療機器などの製造に欠かせないレアアース（希土類）の日本国内での生産をめざす取り組みが始まった。内閣府が主導する計画で小笠原諸島の南鳥島沖でレアアースを含む泥を試掘する探査船が 12 日午前、清水港から出航した。世界のレアアース生産の大半を中国が担うなか、国産資源を開発して輸入が滞る事態に備える。2030 年ごろに商業採掘が始まる可能性がある。

□世界スマホ出荷数 2%増 昨年、アップル 3 年連続首位 2026. 1. 15

米調査会社 IDC は、2025 年のスマホの世界出荷台数が前年比 1. 9%増の 12 億 6030 万台だったと発表した。米アップルが 3 年連続で首位。消費者が関税やメモリ不足に伴う値上げを見越し前倒し購入する動きもあり iPhone など高価格帯のスマホ販売が堅調だった。

アップルが 3 年連続首位に (スマホ出荷台数シェア)



(出所)IDC、2025年

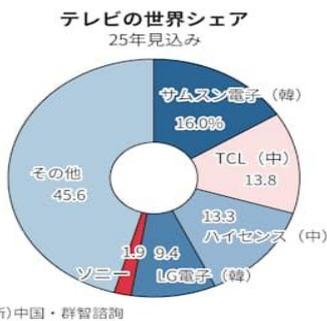
**□割引品ずらり、悩む中国 弱い消費・過当競争、デフレ圧力** 2026. 1. 20

中国経済の失速が鮮明になっている。19日発表の2025年の実質経済成長率は5・0%と、政府目標の「5%前後」は達成したものの、直近の10～12月期では4・5%と3四半期連続で減速。個人消費の落ち込みに加え、過当競争という中国経済が抱える長年の問題も拍車をかけ、デフレ圧力が一層高まっている



**□ソニーグループ、テレビ事業を分離 中国 TCL との合併に承継** 2026. 1. 21

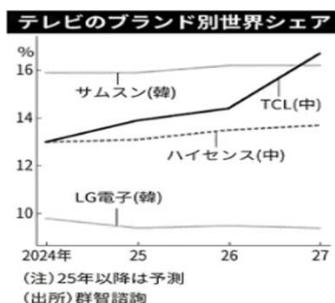
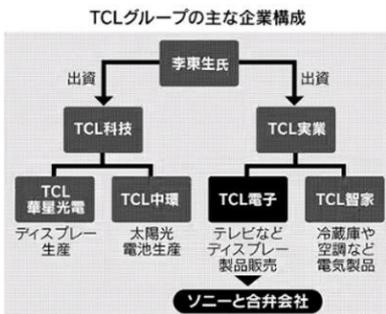
ソニーグループは20日、テレビ事業を分離し、中国のテレビ大手のTCLグループと合併会社を設立すると発表した。出資比率はTCLが51%、ソニーG傘下でエレクトロニクス事業を手掛けるソニーが49%となる。ソニーGはかつての主力だったテレビ事業を切り離し、ゲームや音楽・映画などエンターテインメント事業への集中を鮮明にする。



- ソニーのテレビの歩み**
- 1960年 世界初の「直視型ポータブルトランジスタテレビ」を発売。ソニーのテレビ第1号。ラジオで培った技術を生かして開発した
  - 68年 独自のトリニトロン方式により、カラーテレビ1号機を発売
  - 96年 業界初の水平、垂直両方向にフラットな画面を実現したテレビを発売
  - 2007年 世界初の有機ELテレビ発売。最も薄い部分は3ミリ
  - 19年 よりきめ細かな動画を映すことができる「8Kテレビ」を発売

**□中国 TCL、テレビ首位王手** 2026. 1. 24

**ソニー取り込み規模拡大、51%出資 高価格帯で収益向上**  
中国テレビ大手のTCLグループが世界首位へ王手をかける。高い知名度を持つ「ソニー」ブランドを取り込み、高価格帯の分野をテコ入れする。2027年には韓国サムスン電子を抜き、初めてテレビ首位に立つとの見方がある。



**□コンテンツ立国への挑戦 稼げる IP (知的財産)、日本勢が上位席巻** 2026. 1. 23

世界のIP収入ランキングではポケモンやハローキティなど日本勢が上位を席巻する。コンテンツ関連企業の層の厚さも強みだが、米中に比べて政府予算が少ないのが課題だ。「日本のコンテンツは『まだまだ』といわれるが、実はそうではない。世界がうらやむポジションを確立している」。



□ App le、iPhone 好調で 10~12 月最高益 イスラエルの AI 企業買収 2026. 1. 30



米アップルが 29 日発表した 2025 年 10~12 月期決算は、売上高が前年同期比 16%増の 1437 億 5600 万ドル（約 22 兆円）、純利益が 16%増の 420 億 9700 万ドルだった。新型 iPhone の販売が好調で売上高、純利益とも過去最高。苦戦が続いた中国販売が回復した。同日、アップルがイスラエルの人工知能（AI）開発新興 Q.ai を買収したことが明らかになった。ティム・クック最高経営責任者（CEO）は 29 日の決算説明会でメモリー半導体高騰の影響を問われ「大幅な値上がりが続いており、様々な選択肢を検討する」と述べた。製品の値上げの可能性への言及は避けた。26 年 1~3 月期は売上高が前年同期比 13~16%増になると見込む。1~3 月期はメモリー高騰の影響を織り込んだうえで、粗利率が 48~49%になるとした。

■ AI、生成 AI

□ 「フィジカル AI」 実用時代 ヒト型ロボなど、11 兆円市場に 2026. 1. 7  
現代自、年 3 万台量産 エヌビディアは自動運転向け技術

ヒューマノイド（ヒト型ロボット）の工場などへの大量導入が始まる。韓国の現代自動車は 5 日、2028 年までに人工知能（AI）を搭載するロボットを年 3 万台量産すると発表した。AI でロボットやクルマを自律的に制御する「フィジカル AI」が広がる。

<b>CESでフィジカルAIの発表が相次いだ</b>
<b>韓国・現代自動車</b> 傘下の米ボストン・ダイナミクスのヒューマノイドの量産版
<b>米エヌビディア</b> 自動運転技術の開発基盤「アルバマヨ」
<b>韓国LG電子</b> 洗濯や朝食作りを代行するロボット
<b>中国スタートアップのゼロス</b> 家の中を見守る小型ヒューマノイド

□フィジカル AI に大型資金

2026. 1. 9

2025 年のスタートアップ調達ランク ムジン、ロボ制御に強み

日本経済新聞がまとめた 2025 年のスタートアップの資金調達ランキングでは、ロボット制御ソフト開発の Mujin（ムジン、東京・江東）や、自動運転技術を開発する Turing（チューリング、東京・品川）が上位に入った。人工知能（AI）の性能が進化するなか、ロボットや車を自律的に制御する「フィジカル AI」分野の成長期待が高まっている。

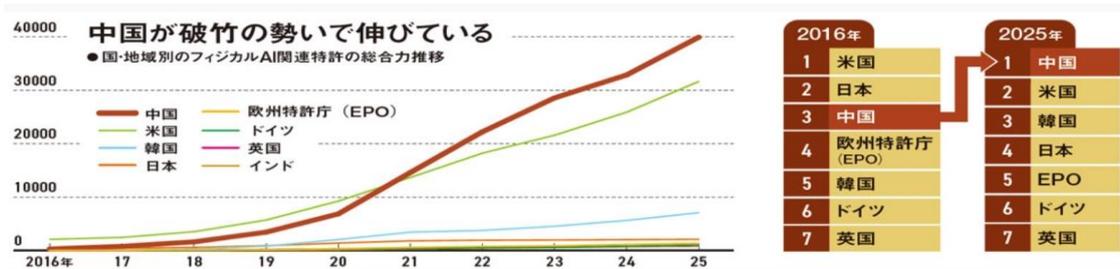
□米アップル、グーグルの AI「ジェミニ」を採用 Siri を改良へ

2026. 1. 13

米アップルとグーグルは 12 日、共同で声明を出し、アップルが次世代 AI（人工知能）の基盤モデルに、グーグルの AI「Gemini（ジェミニ）」のモデルやクラウド技術を採用すると発表した。提携は複数年にわたり、アップルの音声アシスタント「Siri（シリ）」のさらなる個別最適化などに生かされるという。

□ヒト型ロボット、自動運転…「フィジカル AI」特許 破竹の中国、米国越え

2026. 1. 16



フィジカル AI 関連特許の競争力を分析。国・地域別の総合力で世界首位となったのは中国。米国が僅差で追い、韓国や日本が引き離されている構図が浮き彫りになった。特許の蓄積は、テクノロジーが重要な競争力につながる産業において「地力」と位置付けられる。その産業が伸長していく可能性を示す先行指標であり、中国がフィジカル AI 関連産業で優位に立ちつつある状況を示している。

□テスラ、AI 企業へ転換 高級 EV 撤退 ロボ工場に 脱炭素経営も変更 026. 1. 30

米テスラが電気自動車（EV）メーカーから人工知能（AI）企業への事業転換に乗り出した。高級 EV の生産・販売から撤退し、工場の生産品目をヒト型ロボットに切り替える。第二の創業を目指す。「壮大な未来に向けて大きな投資を行う。今年是最初のステップだ」。2025 年 10～12 月期の決算説明会に出席したマスク氏は創業以来初となる事業転換を宣言した。

テスラはAI企業への転換を掲げた	
経営指針	脱炭素の達成から、AIを中心とする社会の実現へと変更
事業転換	高級EV2車種の生産から撤退し、ヒト型ロボットに転用
生産拡大	世界で6つの生産ライン立ち上げ。電池や車両、ロボット、AI半導体など生産
出資戦略	マスク氏が設立したxAI（エックスエーアイ）に20億ドルを出資
自動運転	ロボタクシーを全米7都市で新たに開始。頭脳となる半導体を27年から量産

■その他

□人類 100 億時代、命運握る 所有より体験 違い寛容 2026. 1. 1

「α (アルファ) 世代」は「Z 世代」に続く、2010~24 年ごろに誕生した世代。生まれながらにデジタル端末や SNS に囲まれて育ち、世代人口は史上最多の 20 億人超に達する。人工知能 (AI) が発達し、世界人口が 100 億人超のピークを迎える変革期の主役。α 世代はいまは 16 歳以下で、これから本格的に社会に出る。全員が 21 世紀生まれ。

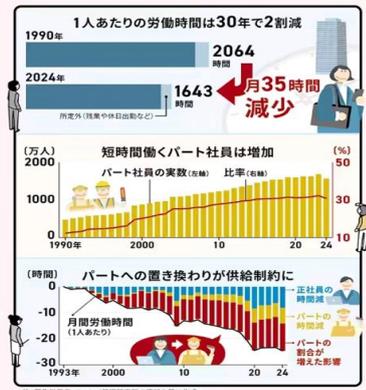


□日本人は働いていないのか 時間は減少、生産性も低水準 2026. 1. 6

「働いて働いて働いて働いて働いて働いてまいます」で 2025 年の流行語大賞を受賞した高市早苗首相が提唱する労働時間の規制緩和。パートタイム社員の増加や残業規制の影響で労働時間が大きく減少。生産性も主要国中で最低水準と日本の供給力は課題に直面している。

3 Graphics

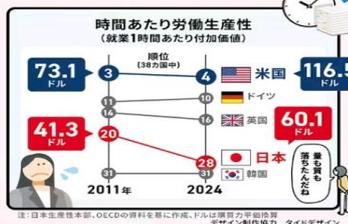
① 労働時間の減少、パート増が影響



② 米国人の方が長く働く

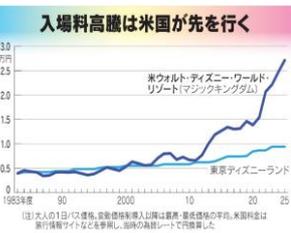
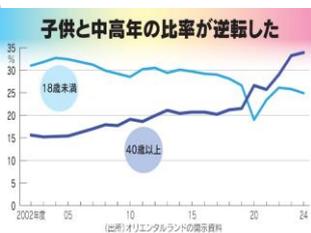
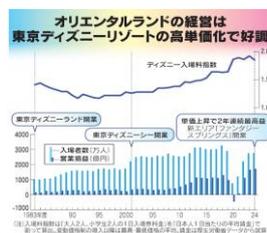


③ 効率の落ち込みも深刻



□ディズニー、夢の国から推しの国へ 中高年来場者が未成年上回る 2026. 1. 15

東京ディズニーリゾートが 1 月に累計の入場者数が 9 億人を超えた。日本人 1 人あたり平均 7~8 回来園している計算だ。1983 年の開園からのデータを振り返ると、α 世代にとって誰もが訪れたい「夢の国」から、熱心なファンが向かう「推しの国」になりつつあることがうかがえる。



## 「半導体産業の実装技術はゲームチェンジの時代に突入する」

- ・半導体の時代がやってきた：「半導体を制するものは世界を制する」国家の安全保障  
 (甘利、麻生、安部各氏が主となった2021年発足「半導体戦略推進議員連盟」からスタート)  
 2025年度補正予算 18兆円のうち3兆円はAI・半導体  
 今後プラス5~10兆円  
 従来は半導体デバイスメーカーへの投資だったが(ラピダス)、今後は装置・材料、  
 電子部品メーカーへの投資も動くだろう。
- ・何が「ゲームチェンジ」となるか？  
 微細加工プロセスの限界、前工程2ナノから0.5ナノがシリコンの限界  
 「後工程」の重要性が高まる。 設備投資も後工程が高まる。
- ・電子デバイス業界 半導体「AIがひっばる」 AIインパクト、データセンター
 

2024年	90兆円	(前年比増24%)
2025年	105兆円	(15%)
2026年予測	125兆円	(20%)
2030年予想	200兆円	
- ・ソニー CMOSイメージセンサー  
 自動車のエコ化(EV)、自動走行運転化(32ヶ/台)カメラモジュール  
 6~7兆円売上規模になる可能性有る
- ・ラピダスの強み
  - ①1.4ナノ IBM技術(GAA)、imec
  - ②後工程 チップレット化、有機基板RDLインターポーザー  
一か所で全行程作る工場として、世界No.1
  - ③光電融合デバイスの立ち上げ  
現在出来るのは、NTT、IBM
  - ④ウルTRASピード 納期2分の1
- ・メモリー 「マイクロン」(広島)HBM  
 「キオクシア」(四日市、北上)NANDフラッシュメモリー  
 酸化物半導体(IGZO)用いた高積層、低消費電力3D DRAM最先端半導体
- ・TSMC熊本 経済効果大 11兆円(2022年~2031年)
- ・後工程 OSA T(Outsourced Semiconduntor Assenbly and Test)の時代  
 「アオイ電子」  
 「ASE」(北九州市) 「アムコーテクノロジー」  
 パッケージ基板 「イビデン」「新光電気」
- ・装置 中国の影響有無の影響がメーカーによってあるが、  
「製造プロセスのレシピは装置メーカーにあり！」
- ・シリコン列島ニッポンの時代が到来、北海道から九州まで拡がる  
 世界シェア 8%から35%になる可能性ある(ラピダス+ソニー+...)

**図表、写真 の出所一覧 (WEB、電子版を含む)**
**■CES**

- ・ 2026. 1. 6 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 10 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 8 朝日新聞

**■ディスプレイデバイス (液晶・有機EL 他)・タッチセンサー・部材**

- ・ 2026. 1. 6 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 6 Phile WEB
- ・ 2026. 1. 19 日経 Xtech
- ・ 2026. 1. 28 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 5 AV Watch
- ・ 2026. 1. 8 AV Watch
- ・ 2026. 1. 21 電波タイムズ

**■半導体**

- ・ 2026. 1. 1 日刊工業新聞
- ・ 2026. 1. 14 日刊工業新聞
- ・ 2026. 1. 21 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 30 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 9 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 17 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 29 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 31 日本経済新聞

**■新技術、材料、電池**

- ・ 2025. 12. 29 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 27 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 29 ニュースイッチ
- ・ 2026. 1. 4 Xeno Spectrum
- ・ 2026. 1. 23 日刊工業新聞

**■カーエレクトロニクス**

- ・ 2025. 12. 30 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 6 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 29 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 3 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 27 日本経済新聞

**■通信 5G/6G (第5世代/第6世代通信)**

- ・ 2026. 1. 10 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 20 日経 TechForesight

**■環境/エネルギー/SDGs**

- ・ 2026. 1. 12 朝日新聞

**■企業動向、製品動向**

- ・ 2025. 12. 31 朝日新聞
- ・ 2026. 1. 7 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 13 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 21 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 23 日経ビジネス
- ・ 2026. 1. 20/21 朝日新聞
- ・ 2026. 1. 8 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 15 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 21 朝日新聞
- ・ 2026. 1. 30 日本経済新聞

**■AI、生成AI**

- ・ 2026. 1. 7 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 21 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 30 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 16 日経ビジネス

**■その他**

- ・ 2026. 1. 1 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 15 日本経済新聞
- ・ 2026. 1. 6 日本経済新聞